

Céramique AS-04

Ceramique は、高速CPUと高容量のクーラーとの熱の伝導性を最大限に引き出すためにアメリカの Arctic Silver 社で開発された画期的な熱伝導剤です。

酸化アルミとボラゾンと酸化亜鉛の超微粒子が主成分です。粒子の平均サイズは380nmと極小です。導電性はありません。シリコンオイルを使用していません。特殊オイルを使用することにより、長期間硬化しにくくなっています。瞬間最大許容温度は180℃です。通常許容温度は-150℃から125℃です。熱伝導の特性は5.1W/m・K以上です(弊社測定値)。従来の熱伝導グリスに比べて、全負荷時に2~10℃もCPU温度を下げます(当社比*)。AS-04は0.08mmの厚さで、約10cm角分ほど塗ることができます。*GS-01との比較



取付方法

- AS-04を使用する前にヒートシンクとCPUコアから熱伝導パッド、あるいはシリコングリスを完全にふき取ってください。弊社の2ステップグリスクリナー(AS-CLN)などの溶剤を使用しますと完全に取れます。
- 表面にゴミなどの不純物がないことを確認してからAS-04を絞り出してください。ヒートシンクはCPUコアに接触する面に塗りつけた後、微細な金属の溝をグリスで埋めるためにレンズ用ティッシュなどのリントフリー紙で拭き取ってください。(ご注意: 指で塗らないでください。指の油により性能が低下します)



AS-04をCPUコアに接触する面に適量を直接指で塗らずにポリ袋などを使い、回すように広げます。レンズ用ティッシュなどで拭き取ります。

- 表面にゴミなどの不純物がないことを確認し、右記のCPUタイプ別グリス塗布場所と量を参考にしてAS-04を絞り出してください。
- 真上からヒートシンクを取り付けます。クリップで固定した後、空気を抜くためにヒートシンクを左右に1~2°回してください。



CPUタイプ別グリス塗布場所と量

シングルコアタイプ (ヒートスプレッドあり)		シングルコアタイプ (ヒートスプレッドなし)	
●グリス塗布場所	●グリス量	●グリス塗布場所	●グリス量
	Intel Pentium 4 (米1.0粒分) AMD 64 (米1.5粒分)		長方形は、写真のように長辺中央に1本線を引きます。 正方形は、写真のように中央に出します。 A 小さいコア 米1.0粒 B 大きいコア 米1.5粒
デュアルコアタイプ (ヒートスプレッドあり)		クアッドコアタイプ (ヒートスプレッドあり)	
●グリス塗布場所	●グリス量	●グリス塗布場所	●グリス塗布場所
	Intel CPU角の三角マークが左下の状態で、ヒートスプレッド中央に薄く1本線で垂直にグリスを引きます。 AMD ヒートスプレッド中央に米1.5粒分のグリスを出します。		Intel Core i3/i5/i7 ●グリス塗布場所 ●グリス量 CPU角の三角マークが左上の状態、ヒートスプレッド中央に薄く1本線で水平にグリスを引きます。
●グリス量	●グリス量	●グリス量	●グリス量
	Intel CPU角の三角マークが左下の状態で、ヒートスプレッド中央に薄く1本線で垂直にグリスを引きます。		Intel CPU角の三角マークが左下の状態で、ヒートスプレッド中央に薄く1本線で水平にグリスを引きます。
	AMD ヒートスプレッド中央に米1.5粒分のグリスを出します。		AMD ヒートスプレッド中央に米1.5粒分のグリスを出します。

i 塗布方法は一例です。ご自身で最適な方法/塗布量をお探してください。

⚠️ ご注意

●最高の性能を発揮するには付着後最低25時間ほどかかります。クロックアップなどの最大発熱を行う前に慣らし運転をお願いします。●本製品は接着剤ではありません。●本製品は自作PC用です。他の用途での使用はしないでください。●子供やペットの手に届かない場所に保管してください。●高温多湿を避け、冷暗所に保管してください。●使用後はキャップを元に戻してください。●長期保管の際は、わずかな分離を防ぐためキャップ側を下にしてください。ただし再度混ぜれば品質に影響はありません。●冷蔵庫などの冷暗所に保管すると分離を低減することができます。●さらに詳しくはArctic Silver社サイトをご覧ください。MSDS(化学物質等安全データシート) 英語版が入手可能です。